2025年6月10日

宇部エクシモ株式会社

「ハイプレシカ®」大粒径タイプの開発について

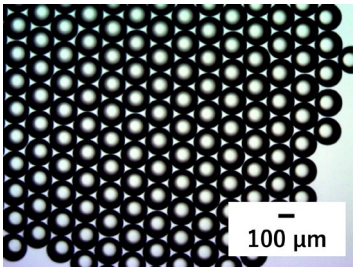
宇部エクシモ株式会社（社長:福永謙二）は、高純度シリカ系粒子(製品名:「ハイプレシカ®」) の大粒径タイプ（～300μm)「ハイプレシカ HS」を開発しました。

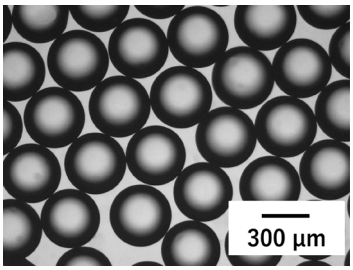
ハイプレシカは高純度、真球形状、極めてシャープな粒径分布が特徴で、主にエレクトロニクス分野（液晶・有機ELディスプレイ、センサ等）において、ギャップコントロール用スペーサーとして使用されています。これまで種々の要望に応じて粒径範囲を拡充し、現在の製品ラインナップは粒径（1.0～70 μm、最小 0.1 μm 刻み）と硬さ（樹脂～ガラス相当）を組み合わせた構成で、さらに樹脂粒子に比べて耐熱性が高く（300℃以上）、圧縮・除荷時の回復性能が優れているといった特徴があります。

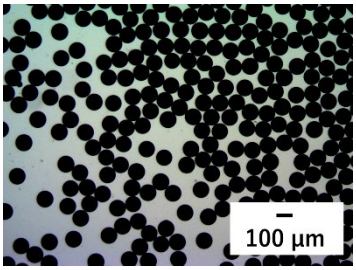
近年、AR/VR ゴーグルや調光フィルムをはじめとする新たな電子デバイスの開発が活発に進められる中、スペーサーのサイズに対する要求も多様化しつつあります。宇部エクシモでは従来のラインナップの上限を超える、大きな粒径の要望にも応じるべく、80～300 μm の粒子を開発しました。基本的な特徴は従来品に準じていますが、粒子の弾性はガラス相当の硬さから汎用樹脂粒子を上回る柔軟性まで調整することが可能となっています。加えて遮光性の付与（黒色化）など、用途に応じたカスタマイズも可能です。

これらの特徴を活かし、これまでよりも大きな厚みの制御が求められる用途や、タッチパネル基板間のスペーサーなど、柔軟性や復元性が求められる用途等への展開が期待されています。今後もハイプレシカの優れた特徴を活かしたまま、お客様のニーズに応じて柔軟にラインナップを展開していきます。

「ハイプレシカ HS」/SEM 写真







遮光性を付与した粒子

＜ニュースリリースについてのお問い合わせ先＞

総務部総務課　TEL:03-6667-2411

URL　https://ube-exsymo.co.jp/

＜製品についてのお問い合わせ先＞

電子材料営業部ハイプレシカ課　TEL:03-6667-2419